

2024.08.21 ニュースリリース

東京工業大学WOWアライアンスに参画し ウエハオンウエハ常温永久接合システムの開発

AIメカテック株式会社(本社:茨城県龍ヶ崎市向陽台、社長:阿部 猪佐雄)は東京工業大学WOWアライアンスに参画し、ウエハオンウエハ常温永久接合システムを開発致しました。半導体事業の新たな提案として最先端半導体パッケージ向け量産プロセスの確立へ貢献して参ります。

本装置は、東京工業大学発ベンチャー企業である株式会社テック・エクステンション様が発表しました台湾での次世代三次元積層半導体向け製造ラインにおいて、ウエハオンウエハの永久接合プロセスを担い、2025年に生産開始されるウエハオンウエハ製造プロセスに納入されます。当社が液晶パネル製造技術で長年培ってきた高精度貼合せ技術を応用し、常温下での貼合せ精度100nm以下のウエハ接合を実現しました。

当社は、ウエハの薄化・積層化に対し重要なプロセスであるウエハ仮接合及びサポートウエハの剥離、洗浄プロセスを含むウエハハンドリングシステムを拡販しています。現在、旺盛なAI市場関連投資を背景に多くの受注、引合を受けております。現行のウエハハンドリングシステムと新たに開発したウエハオンウエハ常温永久接合システムによりHBMを含むメモリー市場など更なる半導体事業の拡大を図って参ります。

当社は、今後も製造プロセスのイノベーションを通してより便利で豊かな生活スタイルの向上により社会に貢献できる企業を目指して参ります。

関連情報

- 1) 株式会社テックエクステンション 2024.4.29 Newsリリース
https://www.tech-extension.co.jp/doc/news_20240430_JP.pdf
- 2) Innolux 2024.4.29 Newsリリース
https://www.innolux.com/en/media_center/news_list/news.html?p=2110

お問い合わせ

AIメカテック株式会社
営業部 TEL:0297-62-9119
<https://www.ai-mech.com/>



ウエハ永久接合ユニット (外観)